

- |                         |                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Record Nr.           | UNICAMPANIAVAN0091181                                                                                |
| Autore                  | Astolfi, Eugenio                                                                                     |
| Titolo                  | 4: Tecnica bancaria : ad uso della quinta classe degli istituti tecnici commerciali / Astolfi, Negri |
| Pubbl/distr/stampa      | Bresso, : Tramontana, 1981                                                                           |
| Edizione                | [Ed. aggiornata con le più recenti realizzazioni del settore bancario]                               |
| Descrizione fisica      | 782 p. ; 21 cm.                                                                                      |
| Altri autori (Persone)  | Negri, Letizia                                                                                       |
| Lingua di pubblicazione | Italiano                                                                                             |
| Formato                 | Materiale a stampa                                                                                   |
| Livello bibliografico   | Monografia                                                                                           |
- 
- |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Record Nr.           | UNINA9910576876203321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Autore                  | Seok Seonho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Titolo                  | MEMS Packaging Technologies and 3D Integration                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pubbl/distr/stampa      | MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2022                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Descrizione fisica      | 1 online resource (210 p.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Soggetti                | Biology, life sciences<br>Research & information: general                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lingua di pubblicazione | Inglese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Formato                 | Materiale a stampa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Livello bibliografico   | Monografia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sommario/riassunto      | This Special Issue introduces recent research results on MEMS packaging and 3D integration whose subjects can be divided as follow; three papers on biocompatible implantable packaging, three papers on interconnect, three papers on bonding technologies, one paper on vacuum packaging, and three papers on modeling and simulation. |

